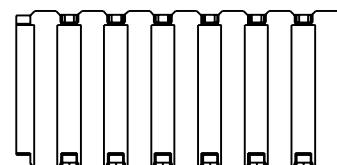
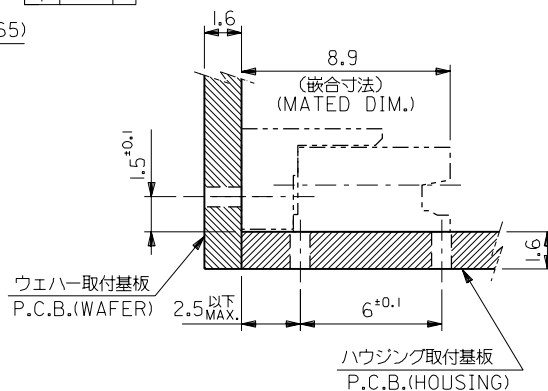
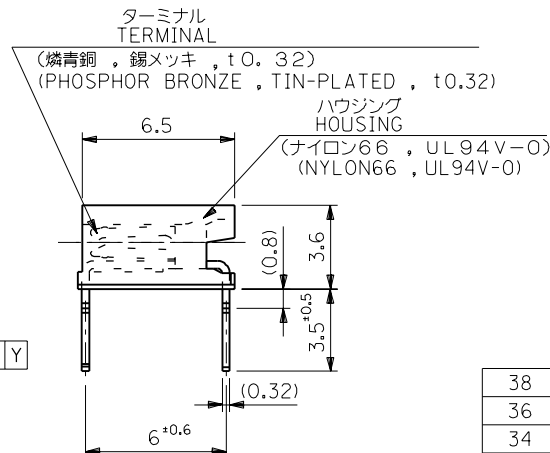
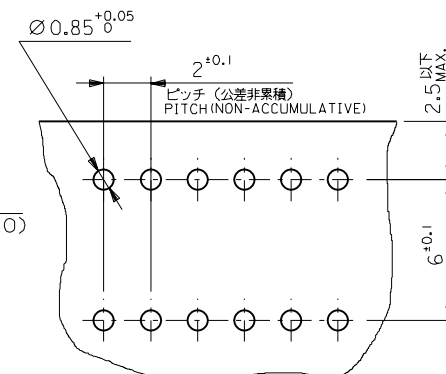


回路番号1表示ステップ
STEP FOR CKT.NO.1トレード・マーク
TRADE MARK

ENG.NO.

 $\oplus \varnothing 0.4 \times Y$ $\oplus \varnothing 0.8 \times Y$ 基板取付推奨レイアウト
P.C.BOARD POSITIONING WHEN MATED基板取付穴推奨寸法
RECOMMENDED P.C.BOARD HOLE DIM.

38	41.9	38	39-51-3200	5513-20APB	20
36	39.9	36	- 3190	- 19 APB	19
34	37.9	34	- 3180	- 18 APB	18
32	35.9	32	- 3170	- 17 APB	17
30	33.9	30	- 3160	- 16 APB	16
28	31.9	28	- 3150	- 15 APB	15
26	29.9	26	- 3140	- 14 APB	14
24	27.9	24	- 3130	- 13 APB	13
22	25.9	22	- 3120	- 12 APB	12
20	23.9	20	- 3110	- 11 APB	11
18	21.9	18	- 3100	- 10 APB	10
16	19.9	16	- 3090	- 09 APB	9
14	17.9	14	- 3080	- 08 APB	8
12	15.9	12	- 3070	- 07 APB	7
10	13.9	10	- 3060	- 06 APB	6
8	11.9	8	- 3050	- 05 APB	5
6	9.9	6	- 3040	- 04 APB	4
4	7.9	4	- 3030	- 03 APB	3
2	5.9	2	39-51-3020	5513-02APB	2
C	B	A	EDP NO.	ENG. NO.	種別 CKT.

材料 図中参照
MATERIAL DESCRIBED IN
THE DRAWING仕上げ
FINISH適用電線範囲
WIRE RANGE被覆外径
INS. RANGE

DRAWN BY '95/10/16

CHK'D BY '95/10/17

APP'D BY '95/10/17

M.FUKUSHIMA

尺度
SCALE 5 : 1MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称

2.0 BOARD TO BOARD

CONN. HSG. ASSY

DWG. NO.

SD-5513-NAPB

REV

E

角度 ANGLE	±3°				
30 以上 OVER	±0.3				
10 以上 30 未満 OVER UNDER	±0.25				
10 未満 UNDER	±0.2				
般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	再作図 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

EN-01(C032)MXJ-32